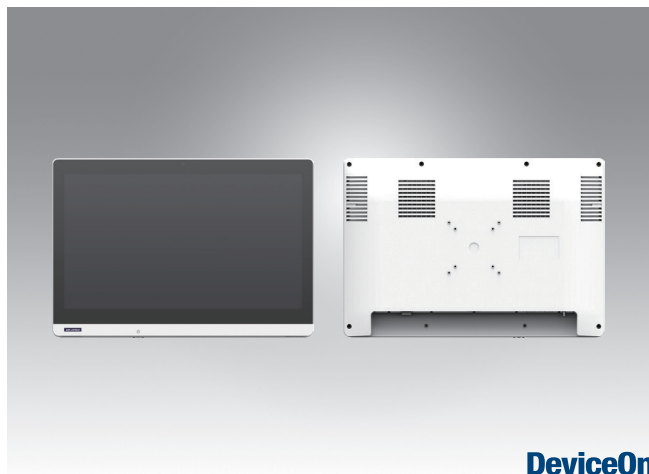


POC-824

23.8英寸医疗级边缘AI一体机 搭载 Intel 第14/13 代CPU 与 NVIDIA GPU



特点

- Intel 第13代 Core i7-13700E CPU
- 23.8"全高清显示屏，多点触控电容屏
- 支持 MXM 模块 A2000 / A4500，以实现高端图形处理
- 前面板IP65等级防水防尘
- 符合 IEC 60601-1 医疗安全规范
- 可选 Wi-Fi, 蓝牙, RFID 与摄像头
- 配备研华DeviceOn远程设备管理软件
- 双 PCIe 插槽，用于图形卡及扩展附加卡



简介

POC - 824配备了集成式固态硬盘，便于进行实时数据处理和存储。它还支持MXM图形模块以及诸如数据采集、I/O扩展等附加卡，适用于高端图形应用。POC - 8系列终端符合IEC 60601 - 1电气设备医疗安全标准，专为在各类医疗环境中可靠运行而设计。

此外，POC - 824 搭载了研华的 DeviceOn/iService 软件，这是一款基于 WISE - DeviceOn 平台的下一代统一设备管理解决方案。DeviceOn/iService 支持批量操作和多设备控制，能够轻松完成设备配置与部署，实现便捷的远程设备管理。

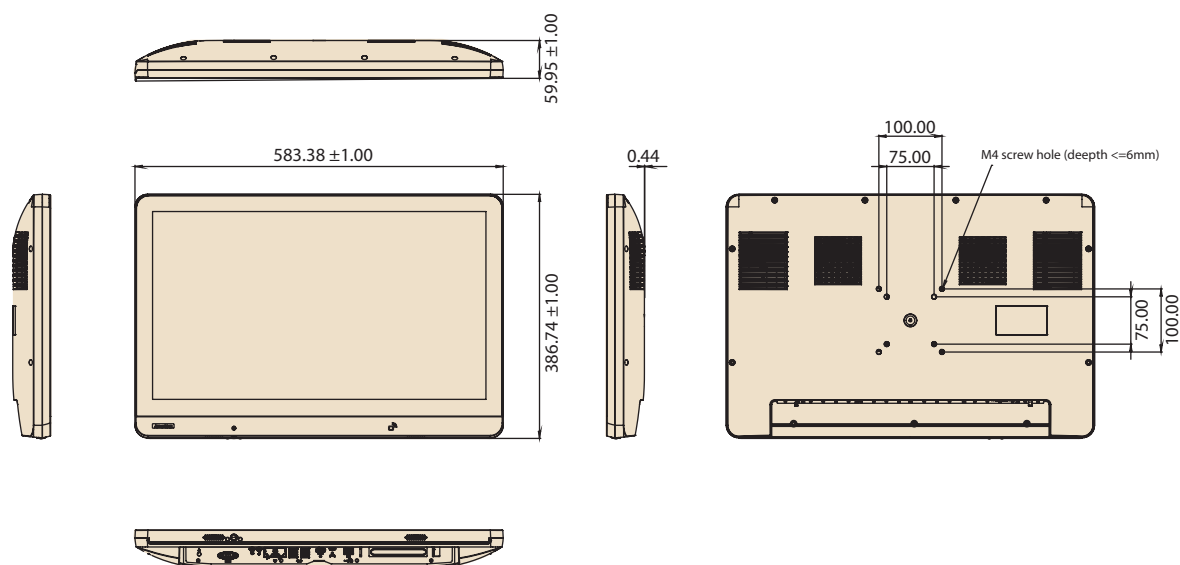
规格

计算系统	CPU*	Intel® Core™ i7-13700E Processor, 16 Core, 1.9GHz (24M Cache, up to 5.10 GHz)
	内存	Support DDR5 Memory up to 64GB (ECC support optional)
存储	操作系统 (可选)	Windows 10 IoT / Windows 11 IoT / Linux (Supported upon request) 64 bits only
	主存	Support NVME M.2 2280 SSD (up to 2TB)
显示屏	第二存储(可选)	Support 2.5" SATA SSD (up to 1TB)
	尺寸	23.8"
触摸屏	最大分辨率	1920 x 1080 Full HD
	类型	Projected Capacitive 10-points (Clear Glass). (AG/AR support by request)
采集卡	MXM 图形卡 (可选)	NVIDIA A2000 (8GB) or A4500(16GB) MXM MSH mode module
I/O 接口	DC In	x 1
	USB 3.2 Type A	x 4
	USB 3.2 Type C	x 1 (with display function / DP ALT mode, 10 Gbps, Max.5V 3A power output)
	HDMI 2.0	x 1
	LAN (Isolation 1.5 KV)	x 2
	Headphone out	x 1
	Mic-In	x 1
	COM (RS232) (Isolation 1.5 KV)	x 1
扩展槽	PCIe x 16	x 1 (The slot is reserved for MXM graphic module)
	PCIe x 4	x 1 (Max. card length 167.65mm, single deck / Max. power consumption 10W)
	M.2 2280	x 1 (for NVME M.2 SSD Primary storage)
	M.2 2230	x 1 (for Wi-Fi/ Bluetooth module)
其他功能	扬声器	x 2 (2W)
	摄像头 (可选)	5M pixel camera available
	TPM	2.0 (default)
电源输入	DC	DC input 24V (Adapter 100~240V/AC, max. 300W)
IP 等级	前面板	IP65
身份验证方案	RFID (可选)	Module as option available
认证	EMC & 安全认证	Medical CE, FCC
		Medical, IEC 60601-1 Compliance (MDR) UL 60601-1 CCC
物理参数	尺寸 (W x H x D)	583.38 x 386.74 x 59.95mm (22.97" x 15.23" x 2.36")
	VESA 安装	100 x 100; 75 x 75 mm
	重量	7.9kg (17.42 lbs)
环境	温度	Operating: 0° C ~ 35° C Storage: 0° C ~ 50° C
	保固	3年

*Other CPUs supported by project. For details, please contact the sales team.

尺寸

单位: mm



I/O 接口



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Equipotential Terminal Pin | 6. 4 x USB 3.2 Gen 2 Type A |
| 2. COM Port (RS232) | 7. HDMI |
| 3. Headphone out | 8. DC-In |
| 4. MIC In | 9. Power Button |
| 5. 2 x LAN Ports | 10. USB 3.2 Gen 2 Type C |

CTOS 服务

裸机

料号	描述	尺寸	CPU	RAM	Touch type	SSD
POC-824-12B010-CA	POC-824 Corei7/P-cap/ w/o RAM, SSD, MXM	23.8"	i7-13700E	NA	P-CAP	NA

*Note: One CPU thermal module default in system barebone already.

MXM GPU (W/ MXM GPU card , MXM carrier board and MXM Thermal Module)

料号	描述	GPU model	Memory size
POC-MXM-102-8A	POC-821/824 MXM A2000 package	A2000	8GB
POC-MXM-104-8A	POC-821/824 MXM A4500 80W package	A4500	16GB

内存

料号	描述
262pin SO DIMM 5600 - Non ECC	
SQR-SD5N8G5K6SNGPB	262pin SODIMM DDR5 5600 8GB 1.1v 1Gx16 (0~95°C)
SQR-SD5N16G5K6SNPB	262pin SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v 2Gx8 (0~95°C)
SQR-SD5N32G5K6SNPB	262pin SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (0~95°C)
SQR-SD5N16G5K6HNAG	262pin SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v 2Gx8 (0~95°C)
SQR-SD5N32G5K6HNAG	262pin SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (0~95°C)
262pin SO DIMM 5600 - ECC	
SQR-SD5N32G5K6SEPB	262pin ECC SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (0~95°C)
SQR-SD516G5K6SEPB	262pin ECC SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v 2Gx8 (-40~95°C)
SQR-SD5132G5K6SEPB	262pin ECC SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (-40~95°C)

NVME M.2 SSD Storage

料号	描述
SQF-C8MV2-256GDEDM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)
SQF-C8MV2-512GDEDM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)
SQF-C8MV4-1TDEDM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)
SQF-C8MV4-2TDEDM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)
SQF-C8BV2-256GDEDM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)
SQF-C8BV2-512GDEDM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)
SQF-C8BV4-1TDEDM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)
SQF-C8BV4-2TDEDM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)

电源线

区域	料号
USA (Thailand, Philippines)	1702002600
Europe (Indonesia)	1702002605
UK (Singapore, Malaysia)	1700032693-11
Japan (PSE)	1700000237

系统

OS 版本	料号
Win10 LTSC 2021	20708WX1HS0028 (for i7/ i9 processor) 20708WX1VS0041 (for i3/i5 processor)
Win11 LTSC 2024	20708WLH1S0006 (for i7/i9 processor) 20708WL1VS0012 (for i3/i5 processor)

2.5" SSD 存储

料号	描述
SQF-S25V1-128GSDC	SQF 2.5" SSD 650 128G 3D BiCS5 (0~70°C)
SQF-S25V1-256GSDC	SQF 2.5" SSD 650 256G 3D BiCS5 (0~70°C)
SQF-S25V2-512GSDC	SQF 2.5" SSD 650 512G 3D BiCS5 (0~70°C)
SQF-S25V4-1TSDC	SQF 2.5" SSD 650 1T 3D BiCS5 (0~70°C)
AMF-S25V2-256GDSBC	AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 256G 3D TLC (BiCS5) (0~70°C)
AMF-S25V4-512GDSBC	AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 512G 3D TLC (BiCS5) (0~70°C)
AMF-S25V4-1TDSBC	AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 1T 3D TLC (BiCS5) (0~70°C)

*Note: Add materials listed under "2.5" SSD mouniting kit" for 2.5" SSD installation

2.5" SSD 安装套件

料号	描述	数量
1960098903N001	2.5" SSD Bracket	1
1940003234	Gasket	1
19330304A0	Screw	8
2130022205T000	Sponge	1
1700024977-21	SATA cable	1
1700022355-21	Power cable	1

Wi-Fi + 蓝牙模组

料号	描述
EWM-W165M201E	Intel AX210 6E 802.11ax + BT5.2 M.2 2230 No.Vpro

推荐安装方案

名称	ARES-2423R
料号	ARES-24R3G-A74IL00
产品图	
G系列抗拉拽VESA	YES
最大支持重量	6-12 kg
最大支持屏幕尺寸	≤ 27"
重量 (VESA certic)	245~375 mm

For more information, please clink this link: <https://bit.ly/3T7dLMR>